

LED芯片晶圆皮秒激光划片设备|半导体芯片切割

产品名称	LED芯片晶圆皮秒激光划片设备 半导体芯片切割
公司名称	深圳市超越激光智能装备股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Beyond laser Tel:18126260045 E-mail:linmengyi@ch
公司地址	中国广东省深圳市龙岗区同乐社区水田一路13号
联系电话	0755-28623985 19878408040

产品详情

传统的激光加工热输入大，在加工过程中会产生热应力使得金属等材料发生变形，但是皮秒激光脉冲宽度可以和电光弛豫的时间相比较，短到足以对材料进行“冷”烧蚀，即几乎没有热效应。

与其他激光加工对比

皮秒激光与普通激光

普通激光加工热输入大，在加工过程中会产生热应力使得金属等薄板材料发生变形，而皮秒激光由于脉冲宽度可以和电光弛豫的时间相比较，短到足以对材料进行“冷”烧蚀，没有热反应，加工的质量更高，表面也更平整。

皮秒激光与纳秒和飞秒激光

纳秒激光虽然凭借高能量输出得到了广泛的应用，但由于其本身加工机理原因，加工过程中不可避免的产生热影响区，再铸层及微裂纹等问题，加工质量不及皮秒激光。

飞秒激光虽然在微加工中体现了其“冷”加工的优势，但是飞秒激光器相较皮秒激光结构复杂、性能不稳定、价格昂贵，难以实现工业化应用。

应用范围广

皮秒激光技术是工业微细加工的可靠工具，这些加工在此前是用其它方法无法完成的。皮秒激光几乎可对所有材料进行微米尺度的加工，这些材料包括但不限于：金属、半导体、钻石、蓝宝石、陶瓷、聚合物、复合材料和树脂、光阻材料、薄膜、ITO膜、玻璃。